

## 마이크로디그리 소개자료

- 반도체설계트랙 마이크로디그리 -
- 인공지능반도체 마이크로디그리 -

총괄책임자

성균관대학교 이강운 교수

사업단명

**반도체설계트랙 마이크로디그리**

산학밀착형 차세대 반도체 융합인력 양성 사업단

**인공지능반도체 마이크로디그리**

산학밀착형 인공지능반도체 융합인력 양성 사업단



# C O N T E N T S

- I 사업 추진 배경 및 필요성
- II 사업 참여 및 이수 요건
- III 교육 체계도
- IV 참여 혜택
- V 마이크로디그리 신청기간 및 사업 관련 문의 안내

# 사업 추진 배경 및 필요성

## 사업 추진 배경



- 분야별 확고한 지식 함양과 명확한 수학 지도를 위한 완성도 높은 커리큘럼 확보 필요
- 반도체 분야의 소통과 협업 능력을 겸비한 인재 수요 증가
- 전 세계적으로 AI, 빅데이터, 블록체인 등 주요 기술을 활용한 서비스 중심으로 사업 구조 개편
- 기술적 흐름에 따른 다양한 서비스를 위해 핵심 부품인 반도체 기술 선점 경쟁이 치열할 것으로 전망



## 사업 추진 필요성



- 인력 수요 증가 대비 기반이 취약하여 인재 양성 필요
- 반도체 설계 분야의 높은 기술 수준을 필요로 함
- 반도체 설계 분야의 학부 교육의 질과 수준 제고
- **산업계 수요 기반의 반도체 산업 인재 양성 및 공급 체계 구축 필요**
- **인공지능의 혁신 인프라를 구축하여 파급효과 확산 및 혁신 성장 유도**

## 02 사업 참여 및 이수 요건

### 반도체전공트랙사업

- 참여조건 : 성균관대학교 학부생 3~4학년
- 이수요건

반도체 설계트랙  
마이크로디그리

반도체 설계 교육 과정  
최소 27학점 이수

기초 공통 9학점(3과목이상)  
반도체 기초 6학점(2과목이상)  
반도체 심화 6학점(2과목이상)  
PBL 6학점(2과목이상) 현장실습 1과목 이수 필수

실무적 능력 향상

PBL 실무 교과목 신설  
현장실습 과목 필수 수강

### 인공지능반도체융합인력양성사업

- 참여조건 : 성균관대학교 학부생 1~4학년
- 이수요건

인공지능반도체  
마이크로디그리

인공지능반도체 교육 과정  
최소 27학점 이수

기초 공통 9학점(3과목이상)  
반도체 기초/반도체심화 12학점(4과목이상)  
PBL 6학점(2과목이상) 현장실습 or \*설계경진대회참가 필수  
\* 설계경진대회는 종합설계프로젝트 과목 수강신청 후 참가하여야  
본교 시스템 상 수료조건으로 인정 됨

실무적 능력 향상

PBL 실무 교과목 신설  
현장실습 과목 필수 수강

## 반도체전공트랙사업

반도체설계트랙 교육체계도

기초 공통 &gt; 반도체 기초 &gt; 반도체 심화 &gt; PBL



## 인공지능반도체융합인력양성사업

인공지능반도체 교육체계도

기초 공통 &gt; 반도체 기초 &gt; 반도체 심화 &gt; PBL



기초 공통9학점, 반도체기초&심화 12학점, PBL 6학점 (산학프로젝트, 인턴십, 인공지능설계대회 택1 필수)



수강생들 중 우수 학생 선정을 통해 해외 학회 지원



인재 확보를 위한 인공지능 반도체 설계 경진대회 참가 자격 제공



사업단 선정 기준을 통한 **우수학생 장학금 지급**  
**1인 최대 250만원(등록금 이내)**



PBL 실무 과목 신설을 통한 **실무 능력 향상**



인턴십 기회 및 컨소시엄 기업과의 교류를 통한  
**취업 정보 제공 및 지원**



## 마이크로디그리 신청 및 사업관련 문의 안내

- 마이크로디그리 2차 신청 기간: 2024년 1월 8일(월)~12일(금)
- 마이크로디그리 참여 후 제출 서류
  - 재학증명서, 성적증명서, 개인정보 동의서 등 마이크로디그리 신청 승인 후 학적사항에 기재된 메일로 안내
  - 정부재원으로 운영되는 사업이므로 서류를 제출하지 않을 경우 수혜인원으로 인정하지 않음



사업관련문의  
[iclabgroup@skku.edu](mailto:iclabgroup@skku.edu)